LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI10_3+4+3_1,50_35

10 - Lagen

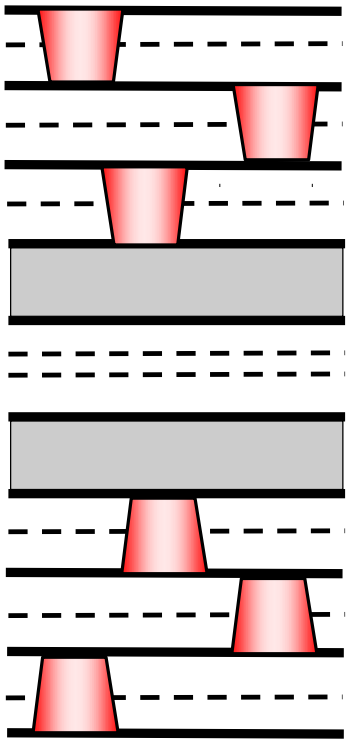
Kerne: 0,36 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.: **3 + 4 + 3**

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

vorl. nur CBT Schopfheim

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK2		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
3	VSK1		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
4	2			35 µm		33	
			0,360 mm			360	
5	3			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
6	4			35 µm		33	
			0,360 mm			360	
7	5			35 µm		33	
					1 x 1080	60	
8	RSK1			12 µm		30	
					1 x 1080	60	
9	RSK2		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
			Gesamtdicke Material:			1480	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,13	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,16	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,18	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	Seite:	10+